

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容:

- (1) CC01080 電子零組件製造業。
- (2) CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- (3) CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (4) CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- (5) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (6) F119010 電子材料批發業。
- (7) F219010 電子材料零售業。
- (8) H201010 一般投資業。
- (9) I301010 資訊軟體服務業。
- (10) I501010 產品設計業。
- (11) JE01010 租賃業。

2.營業比重：

本公司成立於民國 86 年 5 月，以積體電路 IC 封裝測試業務為主，109 年度合併營業比重如下：

單位：新台幣仟元

| 項 目 | 109 年度營收淨額 | 營業比重 |
|---------|------------|---------|
| 封裝服務 | 46,606,101 | 61.18% |
| 測試服務 | 20,936,038 | 27.48% |
| 晶圓級封裝服務 | 3,582,150 | 4.70% |
| 晶圓測試服務 | 4,897,476 | 6.43% |
| 其他 | 158,884 | 0.21% |
| 合 計 | 76,180,649 | 100.00% |

3.目前之商品(服務)項目：

- (1)高腳數超薄小型晶粒承載積體電路(TSOP)封裝及測試服務。
- (2)四邊扁平無腳封裝(QFN)封裝服務。
- (3)多晶片(堆疊)封裝(MCP、S-MCP)封裝及測試服務。
- (4)球型陣列承載積體電路(wBGA、FBGA)封裝及測試服務。
- (5)記憶卡(SD、microSD)、USB 封裝及測試服務。
- (6)固態硬碟(SSD)、內嵌式記憶體(eMMC、eMCP、UFS) 封裝及測試服務。
- (7)DRAM 晶片堆疊封裝及測試服務。
- (8)行動記憶體封裝及測試服務。
- (9)晶圓測試服務。
- (10)晶圓凸塊(Bumping)服務。
- (11)系統級封裝(SiP)服務。
- (12)重佈線(RDL)服務。

- (13)晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)服務。
- (14)封裝體堆疊(PoP、PiP)封裝及測試服務。
- (15)CIS 影像感測器封裝及測試服務。
- (16)覆晶封裝(Flipchip)服務。
- (17)銅柱凸塊覆晶(Cu Pillar Bump Flip Chip)封裝服務。
- (18)EMI shield package 封裝服務。
- (19)面板級扇外型 (Panel level Fan-Out)封裝及測試服務。
- (20)模組(Module)與系統(System)封裝服務。

4.計劃開發之新商品(服務)：

- (1)開發超細線寬與間距(Line/Space 2/2um)之重佈線製程(RDL)的 FOPLP 技術，提供高密度異質晶片封裝產品於高速網路與伺服器等應用領域上，所需的高效能、高 I/O、高頻寬互聯之產品使用需求。
- (2)持續開發扇外型面板級封裝堆疊技術，可提供現有 2.5D 封裝之替代方案，可滿足高階行動通訊產品應用需求。
- (3)持續拓展與開發矽穿孔影像感測器晶片尺寸封裝 (TSV CIS CSP) 技術及產品，以提供高可靠度與高解析度的影像感測器產品需求。
- (4)開發覆晶封裝，以符合各種邏輯產品運用在高速傳輸與運算所需的高效能與高散熱之封裝產品使用需求。
- (5)高速 3D-NAND (1.6Gbps) 測試服務與硬體開發。
- (6) SCM (Storage Class Memory) 測試服務與硬體開發。
- (7) UFS3.0 Automotive Product 測試服務與硬體開發。
- (8) FO Panel Level Test Handler 硬體開發。
- (9) High parallelism CIS 測試服務與相關硬體開發。
- (10) Multi-Die Package 共用 COK 開發。
- (11) Adopt AI Technology 測試後段服務。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

2020 年以來，受新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響，各國政府自第二季起實施相關的封鎖與隔離措施，大幅改變了全球的生活方式，也嚴重衝擊經濟表現。依據國際貨幣基金(IMF) 於 2020 年 4 月所發布的“ Managing Divergent Recoveries”一文，預估 2020 年經濟成長率萎縮 3.3%。時序進入 2021 年，隨著疫苗的推出，預估 2021 年全球經濟將出現強勁復甦，成長率將達 6.0%，2022 年經濟成長率亦可能達 4.4%。

新冠肺炎(COVID-19)疫情改變了工作與生活的方式，遠距辦公與教學帶動了筆記型電腦等電子產品的需求大增，半導體產業因而於 2020 年見到意外的成長。根據半導體產業協會 (SIA) 最新數據，2020 年全球半導體銷售額，將達 4,390 億美元，較 2019 年約有 6.5%的成長。其中，中國為最大的銷售市場，達 1517 億美元，成長率為 5%，美洲市場達 942 億美元，成長率遽增達 20%。

就長期來看，隨著個人裝置和晶片運算設備需求不斷提升，半導體市場將在未來幾年持續成長。除了個人裝置和伺服器之外，半導體的廣大應用包括人工智

慧 AI、5G、電動車與自駕車、IoT 及遠距醫療等均將迅速發展。預期 2021 年半導體產業營收金額，將較 2020 年再成長約 8.4%。

隨著半導體產業的持續成長，台灣在全球半導體產業鏈中的重要性也與日俱增，以 2020 年全球半導體供應國的市占率分布來看，美國位居第一，達 42.9%，台灣則位居第二，市占率有 19.7%。台灣半導體業中的晶圓代工與封測，市佔率分別已超過七成、五成以上，在全球半導體供應鏈中具有舉足輕重的地位。

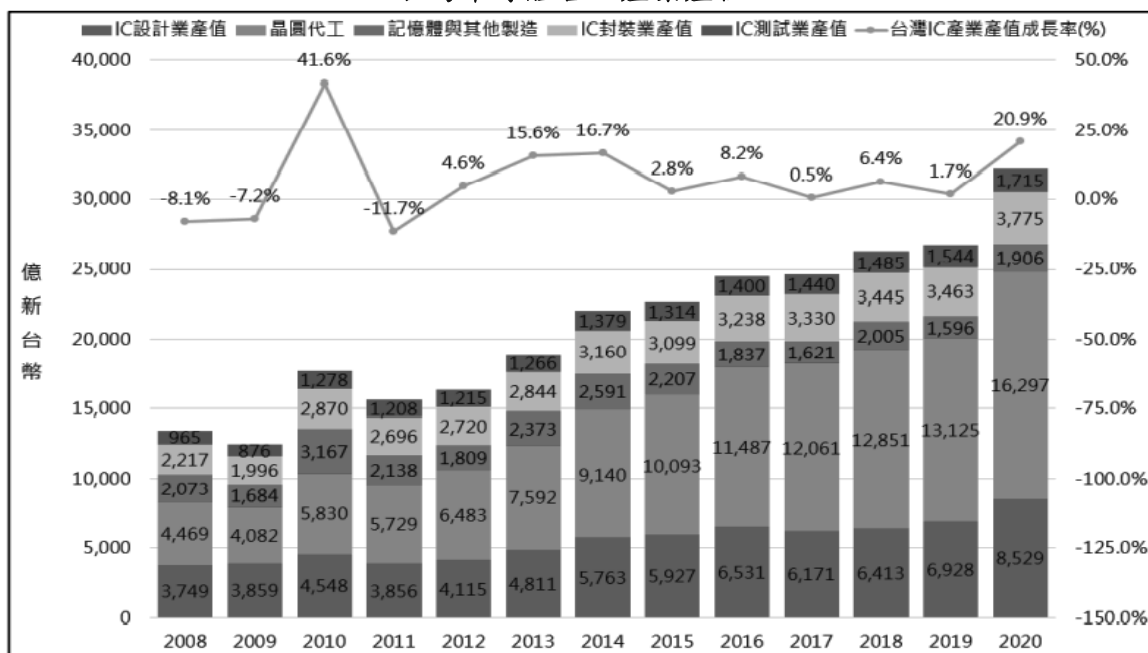
依據工研院產科所資料，2020 年台灣半導體產業產值達新台幣 3 兆 2,222 億元，較 2019 年成長 20.9%，為歷來數字新高。其中，IC 設計業產值為 8,529 億元，較 2019 年成長 23.1%，IC 製造業晶圓代工產值，2020 年達 1 兆 6,297 億元，較 2019 年成長 24.2%。記憶體與其他製造為 1,906 億元，較 2019 年成長 19.4%。IC 封裝業為 3,775 億元，較 2019 年成長 9%。IC 測試業產值則到 1,715 億元，較 2019 年成長 11.1%。

2016年~2020年台灣IC產業產值

| 億新台幣 | 2016年 | 2016年成長率 | 2017年 | 2017年成長率 | 2018年 | 2018年成長率 | 2019年 | 2019年成長率 | 2020年 | 2020年成長率 |
|---------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| IC 產業產值 | 24,493 | 8.2% | 24,623 | 0.5% | 26,199 | 6.4% | 26,656 | 1.7% | 32,222 | 20.9% |
| IC 設計業 | 6,531 | 10.2% | 6,171 | -5.5% | 6,413 | 3.9% | 6,928 | 8.0% | 8,529 | 23.1% |
| IC 製造業 | 13,324 | 8.3% | 13,682 | 2.7% | 14,856 | 8.6% | 14,721 | -0.9% | 18,203 | 23.7% |
| 晶圓代工 | 11,487 | 13.8% | 12,061 | 5.0% | 12,851 | 6.6% | 13,125 | 2.1% | 16,297 | 24.2% |
| 記憶體與其他製造 | 1,837 | -16.8% | 1,621 | -11.8% | 2,005 | 23.7% | 1,596 | -20.4% | 1,906 | 19.4% |
| IC 封裝業 | 3,238 | 4.5% | 3,330 | 2.8% | 3,445 | 3.5% | 3,463 | 0.5% | 3,775 | 9.0% |
| IC 測試業 | 1,400 | 6.5% | 1,440 | 2.9% | 1,485 | 3.1% | 1,544 | 4.0% | 1,715 | 11.1% |
| IC 產品產值 | 8,368 | 2.9% | 7,792 | -6.9% | 8,418 | 8.0% | 8,524 | 1.3% | 10,435 | 22.4% |
| 全球半導體市場(億美元)及成長率(%) | 3,389 | 1.1% | 4,122 | 21.6% | 4,688 | 13.7% | 4,123 | -12.0% | 4,404 | 6.8% |

資料來源：工研院產科國際所

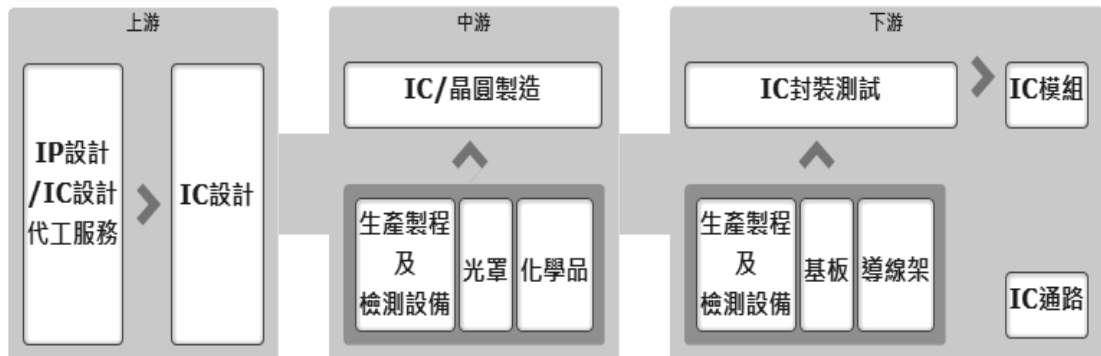
台灣半導體各次產業產值



資料來源：工研院產科國際所

2. 產業上、中、下游之關聯性

我國 IC 產業依製造流程區分，可依次分為上游的 IC 設計(IC Design)、中游的 IC 晶圓製造(IC Manufacturing and Foundry) 及下游的 IC 封裝及測試 (IC Assembly & Testing)。



(1) 上游：

IC 設計屬於知識密集產業，此行業具有高進入障礙的特色，隨著高效能，多功能的電子產品需求，以及 5G、AI、IoT 及汽車電子，工業與消費性的應用多元化，IC 設計產業百花齊放，是半導體供應鏈內重要的一環。其主要業務為自行設計產品銷售，或接受客戶委託設計兩大類。

(2) 中游：

IC 製造業屬資本密集且技術密集的行業，進入障礙高，分為 IDM 公司(廠內自行製造)，與專業晶圓製造代工兩種。其主要業務是將自行設計的 IC 電路或客戶委託加工的 IC 設計，以精密的設備製作出半導體晶圓，隨著晶片效能的提升需求，細線路化，高集積化，晶圓製造的門檻愈來愈高，能夠投資在先進製程的廠商有愈來愈集中化的趨勢。

(3) 下游：

封裝測試產業是將製造完成之 IC 晶圓進一步切割後予以封裝及測試，以應用在最終產品。隨著摩爾定律的進展受限，封裝的角色日益吃重，必須藉由先進封裝的作法，將不同功能的晶片進行異質整合，是封測產業被半導體產業界賦予的重要責任與期待。

3. 總體經濟與產業發展趨勢及產品競爭情形

(1) 總體經濟與產業發展趨勢

IC 封裝測試是 IC 製造的後段作業，包括封裝與測試二項作業程序，主要提供 IC 保護、散熱、電路導通等功能。封裝技術的演進可分為使用導線架的導線封裝與使用載板的無導線封裝。最初是導線封裝階段，以打線接合的方式，將晶片連接至外引腳上，而接腳的位置則位在晶片四周；然後則是載板封裝，使用上以載板取代導線架，對外電路的連通則改用錫球，而錫球(對外的接腳)則為位在晶片的下方；另外有不再使用導線架或錫球，而是直接將晶片置放於母板上，藉由金屬凸塊與載板接合的覆晶封裝技術；隨著電子終端產品持續朝輕薄短小及高速整合運算、省電等趨勢發展，讓扇外型封裝持續受到市

場關注，特別是在扇外型封裝之同/異質晶片或與被動元件整合製程技術開發方面，更是被視為明日之星般的技術。

現今封裝技術二大發展區塊，一是單晶片系統設計 SoC(System on Chip)，是將系統電路整個設計在晶片中，包括中央運算處理單元(CPU)、暫存記憶體(Flash memory 或 SRAM)、數位訊號處理器(DSP)、輸出入介面電路(I/O interface)...等。另一為系統封裝 SiP(System in Package)，它可將不同數位或類比功能的裸晶，以凸塊(bump)或打線(wire bond)方式連結於晶片載板上，該載板中已有部分內埋被動元件或電路設計，此具有電性功能的載板，稱為整合性基板 (Integrated Substrate)或功能性基板 (Functional Substrate)，系統封裝方式也視應用需求而有所差異，例如一般平面型的 MCM(Multi-chip Module)封裝法，或是節省面積將不同功能晶片堆疊起來的 3D 堆疊封裝法，這些都屬於系統封裝(SiP)技術的發展範疇。

半導體產品朝向多功能，效能強化，省電，散熱，與高整合度的發展趨勢，帶動先進封裝朝向系統級封裝 (SiP) 與異質整合封裝 (Heterogeneous Integration) 的趨勢，這些需要面板級扇外型封裝 (Panel Fan-Out)、矽穿孔 (TSV)、內埋式封裝 (Embedded Package)、晶片薄化 (Thin Wafer)、晶片堆疊 (Chip Stacking)、細間距覆晶 (Fine Pitch Flipchip)、高密度模封 (High Density Encapsulation)、天線整合封裝 (AiP)、高密度表面焊接 (High Density SMT)，系統組裝 (System assembly) 及測試 (Testing) 等技術的整合。未來的產品趨勢，將需要整合各種先進的技術，一家封測廠唯有具備各樣的封測技術，方能提供客戶完整與高品質的產品，並在競爭激烈的半導體業界佔有領導地位。

本公司為因應產業及技術發展態勢及上游客戶對記憶體、邏輯及先進封裝測試產能日益增加的需求，適時購置新設備以提高產能，以持續提供且盡力滿足現有客戶封裝及測試服務，並以此為基礎更積極朝向低成本高效能封裝技術前進，於 2018 年 9 月投資興建全球第一座使用面板級扇外型封裝 (Fan-Out Panel-Level Packaging, FOPLP) 製程的量產基地，力成科技看好面板級扇外型封裝技術未來的發展，可運用於 5G、AI、生技、自駕車、智慧城市及物聯網等的相關產品上，並對其未來產品的推廣有明顯的助益。本著未來封測產業會走向更多元化及高技術的趨勢，有能力研發出自家技術及培養穩定客戶訂單來源的廠商，將會是未來最大的贏家。

(2) 競爭情形：

2020 年台灣 IC 封測業產值約為新台幣 5,490 億元，佔全球半導體封測市場超過五成，全球前十大封測廠中有 5 家為台灣廠商。

本公司在封測領域耕耘多年，在堆疊式晶片封裝技術領域領先全球前五大半導體封測廠，2020 年全年累計營收為新台幣 761.81 億元，較 2019 年成長 14.51%，其中 Flash 營收佔比為 39%、DRAM 營收佔比為 23%、邏輯晶片營收佔比為 27%、系統級封裝 (SiP) 及模組之營收佔比為 11%。

以往的系統單晶片(SoC)是把許多相同製程節點(technology node)元件整合在同一個晶片上，當先進製程持續推進到7奈米、5奈米，IC製造成本會大幅度提高，然而並非每一家IC設計公司都能夠負擔先進製程的昂貴成本，本公司著眼於此，積極研發各種先進封裝技術，在「異質整合」先進封裝技術與產能的佈局上領先同業，投入面板級扇外型封裝(Fan-Out Panel-Level Packaging; FOPLP)技術，透過FOPLP可將不同製程節點的不同功能元件進行整合，是較具成本效益的封裝方式，效能可與用先進製程製造的SoC相仿，換言之，是透過「把多個製程節點的元件異質整合在同一個晶片封裝上」，以協助客戶達成技術領先與提升經濟效益。

力成科技擁有完整的半導體後段封測能力，足以提供客戶從凸塊(Bumping)、晶圓測試(Wafer Sort)、晶圓級封裝(WLCSP)、鐳線封裝(Wire bond Package)、覆晶封裝(Flipchip Package)、系統級封裝(System in Package; SiP)、面板級扇外型封裝(Panel Fanout)、3維矽穿孔(3DIC TSV)、系統級測試(Final Test)及模組與系統級組裝(System Assembly)等服務，客戶可一次滿足半導體後段所需的所有服務。力成科技具有技術能力強、生產天數短、良率高及成本低等優點，這是本公司得以在競爭激烈的後段封測中，持續與客戶共同成長的關鍵因素。

2020年全球前十大封測廠之台灣廠商排名及2015年~2020年成長態勢

單位：新台幣百萬元

| 公司名稱 | 2020年 營收 | 20/19 成長率 | 2019年 營收 | 19/18 成長率 | 2018年 營收 | 18/17 成長率 | 2017年 營收 | 17/16 成長率 | 2016年 營收 | 16/15 成長率 | 2015年 營收 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 日月光 | 476,979 | 15.4% | 413,182 | 4.0% | 397,261 | 36.8% | 290,441 | 5.7% | 274,884 | -3.0% | 283,302 |
| 力成 | 76,181 | 14.5% | 66,525 | -2.2% | 68,039 | 14.1% | 59,632 | 23.4% | 48,344 | 13.7% | 42,524 |
| 京元電 | 28,959 | 13.4% | 25,539 | 22.7% | 20,816 | 5.7% | 19,686 | -2.0% | 20,081 | 17.2% | 17,129 |
| 碩邦 | 22,275 | 9.1% | 20,419 | 9.0% | 18,725 | 16.4% | 18,428 | 6.8% | 17,256 | 2.3% | 16,863 |
| 南茂 | 23,011 | 13.1% | 20,338 | 10.0% | 18,480 | 3.0% | 17,941 | -7.5% | 19,392 | -2.4% | 19,869 |

資料來源：公開資訊觀測站/各公司財報，力成公司整理

註：日月光與矽品於2018年4月時，以股份轉換方式設立日月光投資控股(股)公司

(三)技術及研發概況

1.研發費用

本公司最近年度研發費用支出情形詳如下表：

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度 | 109 年度 |
|---------|-----------|
| 研發費用 | 2,196,321 |

2.開發成功之技術或產品：

(1) 封裝產品方面的成果：

- A.利用RDL first(chip last) 重佈線製作電路substrate及扇外型面板級封裝 (Fan-Out Panel Level Package, FOPLP)工藝，成功開發結合內埋式被動元件的車用系統晶片封裝，通過客戶端完整的可靠度驗證。
- B.實現超細線寬與間距(Line/Space 3/3um)重佈線製程(RDL)之FOPLP技術開發與驗證，運用在高速運算處理晶片。
- C.以扇外型面板級封裝 (Fan-Out Panel Level Package, FOPLP)之chip middle製程技術，成功整合系統晶片(SoC)與高頻寬記憶體 (HBM)，可滿足產品應用於HPC/AI領域所需之資料運算與低延遲資料傳輸的功能使用需求。
- D.以扇外型面板級封裝 (Fan-Out Panel Level Package, FOPLP)之chip middle製程技術，整合發光二極體與控制晶片，以應用於娛樂、醫療、教育等領域的AR/VR裝置。
- E.以扇外型面板級封裝 (Fan-Out Panel Level Package, FOPLP)之chip middle製程技術，成功開發嵌入式整合橋接晶片 (Embedded Die)，可作為應用於高階行動裝置與高速運算處理器之高密度異質整合方案。
- F.量產深具成本競爭力的無凸塊(Bump free)扇出及多層重佈線的扇外型面板級封裝產品，應用於行動裝置、穿戴式裝置及消費性產品等領域的多項封裝產品。
- G.成功開發以矽穿孔(Through Silicon Via, TSV)封裝技術的超薄型、高密度堆疊之高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory, HBM)產品。
- H.成功開發應用於行動裝置、醫療、監控及車用領域等應用市場的矽穿孔影像感測器晶片尺寸封裝 (TSV CIS CSP) 技術，預計2021年下半年可以進入量產階段。
- I.完成天線封裝 (Antenna in Package, AiP) 技術開發及射頻 (Radio Frequency, RF) 實驗室的建置，可協助客戶加速在5G高頻封裝產品上的開發與驗證。
- J.量產大尺寸覆晶球柵陣列(Flip Chip BGA, FCBGA)封裝，可滿足資料中心及伺服器等高速運算晶片需求。

(2) 測試產品方面的成果：

- A. WiFi 6E and BTC測試服務。
- B. PCIe Gen4系統級測試服務與硬體開發。
- C. High Density 3D-AND測試服務與硬體開發。
- D. Teradyne IP750 CIS測試服務與相關硬體開發。
- E. Advantest T5503HS高速測試板開發。
- F. hin package COK開發。
- G. O/S測試機台開發。

(四)長、短期業務發展計劃

茲就本公司有關經營、生產、行銷、研發等策略領域之短期及長期發展計劃之內容說明如下：

1.短期發展計劃

(1)積極開發新製程及技術

技術領先為本公司著重的經營方向之一。因應半導體應用產品的多樣化，與所需的封裝技術的差異，力成科技將持續開發新製程及技術能力，以期滿足業界所需。舉例來說，CIS 影像感測器的先進封裝技術，將是力成短期發展的重點產品之一。

(2)持續縮短製程週期，以提供客戶更迅捷之服務

本公司之生產利基為彈性且快速的產能調整，提供客戶具有競爭力的生產週期。

(3)持續提供整合性服務(Turn-Key Service)

由於上游晶圓廠基於成本考量，逐漸將 IC 之封裝及測試業務外移至專業封裝廠及測試廠，本公司為國內少數能同時提供先進技術的封裝及測試專業領導廠商，得以提供客戶完整的服務，未來將持續提供整合性服務，提供本公司在客戶供應鏈內的價值。

(4)擴展國內外市場，擴大市場佔有率

本公司具有提供整合性服務之優勢，除與現有國內外客戶維持良好關係外，將積極爭取國內外新客戶，擴大市場佔有率。

2.長期發展計劃

(1)注重與客戶之間的長期合作關係

強調與上下游廠商的長期合作，在產業專業分工的趨勢中，本公司已是客戶信賴與倚賴的封裝測試夥伴，提供客戶需要的品質與服務，與客戶共同成長。

(2)注重與供應商之間的長期合作關係

半導體設備及材料等供應商，是力成多年來得以成長茁壯的關鍵。本公司本於與供應商互利雙贏與共同成長的期許，將持續強化完整的供應商合作關係。

(3)提高自動化生產，強調智慧工廠，提高產品良率並增進生產效率。

(4)持續開發下世代所需的封裝測試技術

力成科技始終走在業界之先，開發客戶所需的先進封裝技術。自 2006 年成立封測研發中心以來，在新技術專利創新研發的成果，居業界領導地位，並衝諸適當的時間點，將之引進量產。展望未來，技術是力成持續創新的根本，本公司將一如既往在技術創新的領域深耕。

(5)持續增加邏輯產品、系統及模組封裝測試營收

藉由增加邏輯產品封測、系統及模組封裝測試，以擴大客戶規模及營收，期能提升產業領導地位，並分散產業風險。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司主要產品為提供 IC 封裝及測試服務，銷售地區包含國內外市場，109 年度內銷比重約 20.15%；外銷比重為 79.85%，以日本、新加坡及美洲地區為主。

單位：新台幣仟元

| 銷售地 \ 年度 | 108 年度 | % | 109 年度 | % |
|----------|------------|-------|------------|-------|
| 內銷 | 13,401,920 | 20.15 | 15,347,846 | 20.15 |
| 外銷 | 53,123,224 | 79.85 | 60,832,803 | 79.85 |
| 日本 | 23,245,391 | | 27,395,237 | |
| 新加坡 | 13,147,802 | | 14,378,679 | |

| 銷售地 \ 年度 | 108 年度 | % | 109 年度 | % |
|----------|------------|-----|------------|-----|
| 美洲 | 12,634,897 | | 13,111,792 | |
| 歐洲 | 2,367,141 | | 2,281,902 | |
| 中國大陸及港澳 | 1,133,562 | | 1,085,555 | |
| 其他 | 594,431 | | 2,579,638 | |
| 合計 | 66,525,144 | 100 | 76,180,649 | 100 |

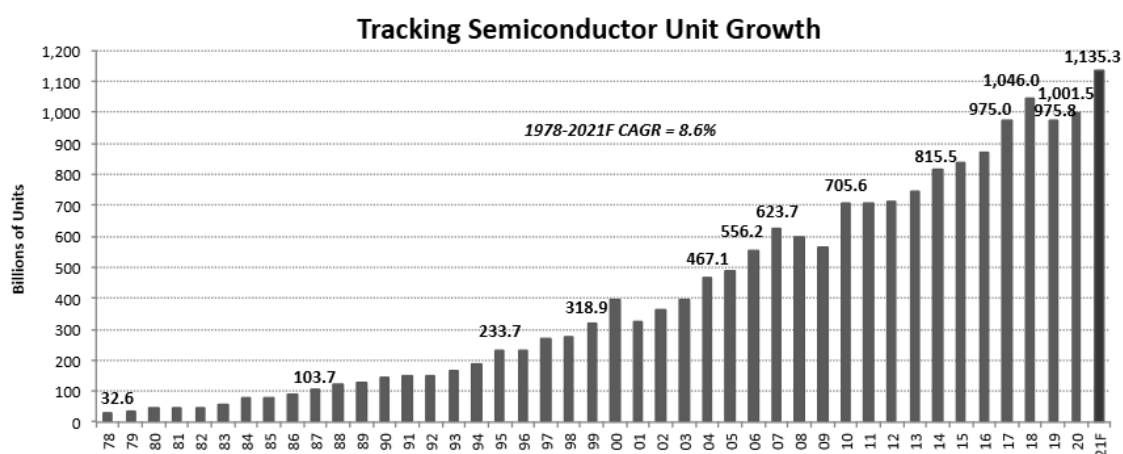
2. 市場占有率

2020 年全球半導體封測，因為各類應用的需求大增，封測產能幾近滿載，大部分封測廠均出現高度成長。依據 Chipinsight 預估，2020 年全球封測營業額前十大中，力成名列第四名，排名與 2019 年相同，但市占率將從 2019 年的 8.01% 成長為 2020 年的 8.18%，顯示力成科技持續踏著穩健的步伐成長。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

展望 2021 年，依據國際半導體產業協會(SEMI)於三月份發布的年度市場展望，由於看好資料中心，5G 應用，高效能運算，以及人工智慧等應用，將持續對半導體產業注入成長動能，除了半導體製造與封測持續看好外，也帶動半導體設備與材料產業的成長趨勢。

另外，依據世界半導體貿易統計組織(WSTS)資料，預估半導體市場在 2021 年將成長 10.9%，市場成長的動能來在於感測器成長 16.8%，類比 IC 成長 15.2%，以及邏輯 IC 成長 13.0%。研究機構 IC insight 於四月發布的研究報告也預估 2021 年半導體的總出貨量將成長 13%，創下年度新紀錄。



4. 競爭利基

力成科技長年以來，以優異的生產良率與品質，用心的服務，及創新的技術，與世界一級客戶建立了既深且長的密切合作關係，本公司具備之競爭利基如下：

(1)堅強的策略聯盟/走向全球化：

IC 封裝業及測試業與上游晶圓製造廠之互動程度高，因此，封裝及測試之獲利因素在於穩定之客戶來源，而 IC 製造廠鑑於其產品技術、產品品質、生產程序之保密性，亦會選擇與 IC 封裝及測試業之長期合作，因而形成策略聯盟，並與之有長期穩定之合作關係，有利於未來公司之長期發展。

(2)整合性的全面服務：

本公司同時提供 IC 封裝及 IC 測試之一元化服務，以降低產品來回運送之成本與風險，以符合客戶需求，提高公司競爭利基。

(3)優秀的研發與製程能力：

本公司致力於創新技術研發，並對生產製程改善不遺餘力，至今已取得國內外多項專利，奠定厚實的技術研發基礎與能量。

(4)自動化及高精密度機台引進：

本公司因應積體電路 IC 產品朝高功能、高腳數、高積度和尺寸小型化發展，為提昇為客戶服務品質，引進先進自動化及高精密度設備，以符合客戶需求。

(5)網路自動化客戶服務系統：

本公司利用網際網路系統資訊傳遞及系統持續的改善，客戶可以隨時掌握產品問題及目前進度，瞭解產品狀況，有助於產品之改善及快速解決問題，提高對客戶之附加價值。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素：

【產業環境】

①台灣半導體產業的競爭優勢

台灣半導體產業擁有完整的半導體產業結構，從上游的 IC 設計、晶圓製造至下游的封裝測試，垂直整合的產業鏈符合產業趨勢需求，造就台灣半導體產業在國際市場之競爭地位。IC 產業的榮景隨著全球電子、資訊、通信、消費性電子、光電工業、人工智慧以及物聯網蓬勃發展，將使 IC 封裝、測試業持續穩定發展。

②IDM 大廠委外趨勢有利於封測市場

因先進製程需要高額資本支出，使得全球 IDM 廠陸續擴大晶圓代工與封測委外業務於生產成本較低的亞洲地區，因此，具有 IC 產業完整與動態垂直分工體系的台灣，成為國際 IDM 與 IC 設計公司委外代工的首選，台灣封測廠亦獲益於 IDM 委外訂單。

【公司利基】

①穩健的策略聯盟及經營團隊—

力成科技的主要股東與經營團隊，長年來穩定用心經營，形塑公司穩健踏實的企業文化，此有助於公司知名度之建立及訂單來源之穩定。另外，本公司之經營團隊皆具備半導體領域之完整資歷，能洞悉市場趨勢，帶領公司力抗不景氣，調整作法，擬定與時俱進的公司策略。

②持續的研發及創新—

因應市場的快速變遷，力成建構了完整的封裝、測試與模組產品的研發團隊，全面致力技術深耕，並透過技術合作引進先進技術。

③整合性的全面服務—

本公司可完整提供半導體後段封測所需的各式生產技術，從傳統的導線架封裝，到最先進的矽穿孔或面板級扇外型封裝。全面性的技術服務，讓力成科技得以在世界的封測產業中持續成長。

(2)不利因素及因應措施：

①IC 產業隨景氣波動

因應對策：

A.產品多角化佈局

除了持續維持並強化在記憶體 IC 封裝測試技術的領導地位外，也積極打入邏輯 IC 的封測市場，藉由銅柱凸塊(copper pillar bump)，金屬線路鋸墊重分配製程(Re-distribution；RDL)，晶圓級封裝(Wafer Level CSP)，以及面板級扇外型封裝等新製程技術，得以快速進軍邏輯 IC 領域。公司藉由多角化的產品降低景氣循環的風險，提供客戶更多元化之封測服務。

B.強化與客戶的合作模式

與現有客戶建立長期策略聯盟夥伴關係，並積極開發新客戶，使產能得到充分而穩定的利用。

C.擴大市場服務範圍

積極進軍日本與歐美市場，並切入汽車、5G 及工業等應用，擴大客戶與產品應用範圍。

②原物料上漲，侵蝕毛利

因應對策：

A.降低生產成本

改變產品結構、改善良率、提出可替代材料之解決方案，並持續改良製程能力，降低成本上漲之影響。

B.強調附加價值

持續站在客戶立場，提供品質好、交期短、快速應變客戶需求的服務。致力研發新的封裝測試技術，使客戶在市場上推出具有時效性及競爭優勢之產品。

C.與供應商建立長期合作

本公司積極與設備及材料供應商建立長期穩固的合作關係，進而達到雙贏的目標。

③基層勞工短缺

因應對策：

A.提高員工福利並適時給予激勵獎金以吸引優秀人才加入，凝聚員工向心力。本公司依未來之發展計劃需要，擬定員工教育訓練，使員工與企業共同成長。

B.本公司引進先進之自動化機器設備，積極投入工業 4.0 開發，減低對基層員工之需求，有效提昇員工生產力。

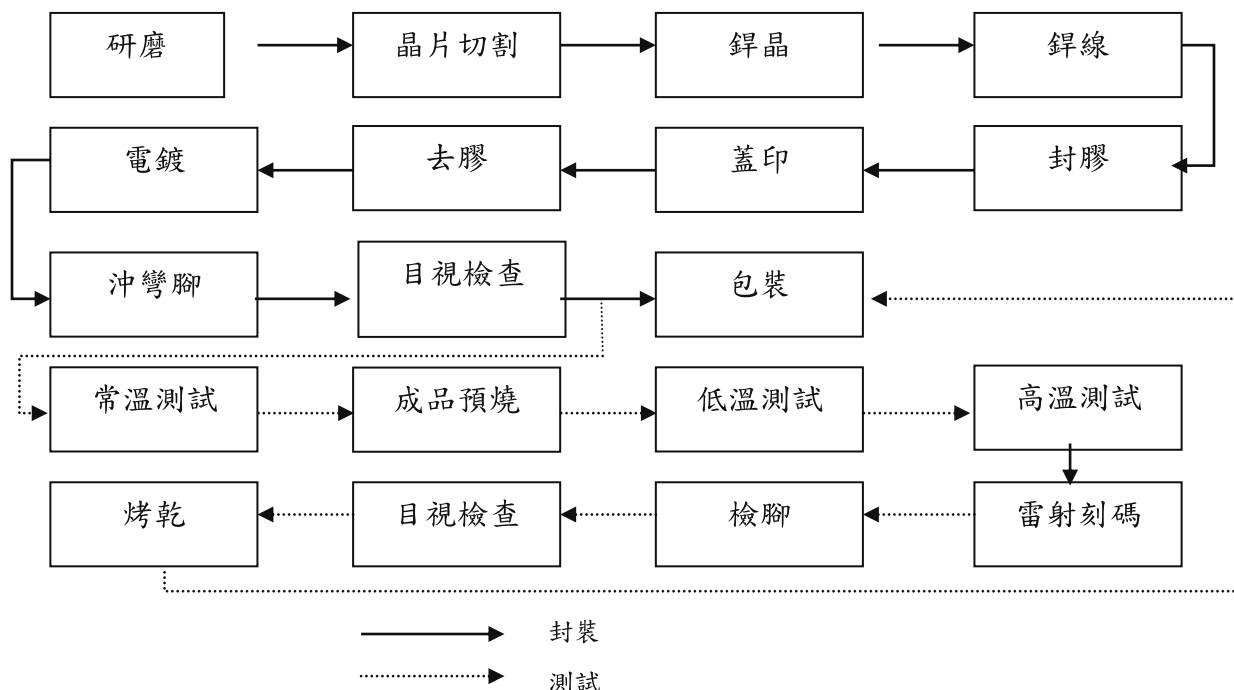
C.透過行政院勞工委員會之核准引進外勞，以解決勞工短缺之困擾。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.產品用途：

| 主要產品或服務項目 | 重要用途或功能 |
|----------------------|--|
| 積體電路(IC)封裝(Assembly) | 將積體電路(IC)由晶圓產品經由切割、黏合、接線、封膠、切腳、成型等製程完成單顆成品。 |
| 環境分類測試 (Final Test) | 依客戶所指定之測試條件，將產品 (IC) 置於不同的環境如常溫、高溫或低溫中測試並分類，確保客戶所提供的產品符合其所要求的品質及穩定性。 |
| 成品預燒 (Burn-In) | 運用預燒 (Burn-In) 製程，讓產品 (IC) 處於極端的環境中運作，加速產品的老化並予以篩選，以確保產品的可靠性。 |
| 雷射刻碼 (Laser Mark) | 於產品 (IC) 封裝上刻印廠商名稱及產品類別。 |

2.產製過程：



(三)主要原料之供應狀況

本公司主要是為客戶提供之 IC 予以加工，其中封裝作業需使用主要原料之供應狀況如下：

| 主要原料 | 主要供應商 |
|----------------------|--|
| 導線架(Lead Frame) | Shinko Electric、NICHIDEN SEIMITU KOGYO CO LTD. |
| 基板(Substrate) | 南亞、SIMMTECH、STG、Shinko、景碩、臻鼎、深南電路 |
| 黏晶膠(Die attach Film) | SHOWA DEMKO(HK)、台灣日東電工、琳得科先進科技、Henkel |

| 主要原料 | 主要供應商 |
|---------------|--|
| 金線(Gold Wire) | 日茂新、Tanaka |
| 樹脂(Compound) | 台灣昭和、SHOWA DEMKO(HK)、Shin Etsu、Kyocera、晁揚、長華 |

(四)最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1.本公司主要供應商名單：

單位：新台幣仟元

| 項目 | 108年 | | | | 109年 | | | | 110年度截至第一季止 | | | |
|----|------|------------|---------------|---------|------|------------|---------------|---------|-------------|-----------|-------------------------|---------|
| | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占當年度截至前一年度第一季止進貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 |
| 1 | 甲 | 1,886,899 | 8.96 | 無 | 甲 | 2,951,768 | 10.72 | 無 | 甲 | 599,989 | 9.27 | 無 |
| | 其他 | 19,169,128 | 91.04 | | 其他 | 24,594,203 | 89.28 | | 其他 | 5,872,298 | 90.73 | |
| | 進貨淨額 | 21,056,027 | 100 | | 進貨淨額 | 27,545,971 | 100 | | 進貨淨額 | 6,472,287 | 100 | |

增減變動原因：市場需求提升，公司產能擴充，封裝產量大幅增加，主要材料進貨金額占全年度進貨金額比例相對提高。

2.本公司主要銷貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

| 項目 | 108年 | | | | 109年 | | | | 110年度截至第一季止 | | | |
|----|------|------------|---------------|---------|------|------------|---------------|---------|-------------|------------|-------------------------|---------|
| | 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占當年度截至前一年度第一季止銷貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 |
| 1 | 甲 | 17,934,998 | 26.96 | 關係人 | 甲 | 21,607,896 | 28.36 | 關係人 | 甲 | 4,672,309 | 25.35 | 關係人 |
| 2 | 乙 | 14,818,184 | 22.27 | 無 | 乙 | 16,116,653 | 21.16 | 無 | 乙 | 3,692,128 | 20.04 | 無 |
| 3 | 丙 | 9,319,159 | 14.01 | 無 | 丙 | 11,035,903 | 14.49 | 無 | 丙 | 2,213,300 | 12.01 | 無 |
| | 其他 | 24,452,803 | 36.76 | | 其他 | 27,420,197 | 35.99 | | 其他 | 7,851,496 | 42.60 | |
| | 銷貨淨額 | 66,525,144 | 100 | | 銷貨淨額 | 76,180,649 | 100 | | 銷貨淨額 | 18,429,233 | 100 | |

增減變動原因：受中美貿易戰及疫情影響遠距工作需求增加，進而使 IC 需求增加，因此營收增加。

(五)最近二年度生產量值

數量單位：仟顆；仟片 金額單位：仟元

| 生產量值 | 年度 | 108 年度 | | | 109 年度 | | |
|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 產能 | 產量 | 產值 | 產能 | 產量 | 產值 |
| 封裝 | | 12,633,942 | 11,083,932 | 30,073,884 | 15,437,158 | 13,771,870 | 35,221,455 |
| 測試 | | 8,861,588 | 6,715,326 | 13,151,756 | 9,919,695 | 8,611,083 | 15,955,862 |
| 晶圓級封裝 | | 1,300 | 774 | 2,483,523 | 1,366 | 863 | 2,585,149 |
| 晶圓測試 | | 1,204 | 1,068 | 2,272,550 | 2,551 | 1,857 | 4,261,861 |
| 合 計 | | 21,498,034 | 17,801,100 | 47,981,713 | 25,360,770 | 22,385,673 | 58,024,327 |

(六)最近二年度銷售量值

數量單位：仟顆；仟片 金額單位：仟元

| 銷售量值 | 年度 | 108 年度 | | | | 109 年度 | | | |
|-------|----|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 內銷 | | 外銷 | | 內銷 | | 外銷 | |
| | | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 |
| 封裝 | | 6,304,864 | 8,519,264 | 4,815,833 | 31,664,280 | 8,099,698 | 9,967,064 | 5,592,115 | 36,639,037 |
| 測試 | | 4,217,109 | 2,271,432 | 2,548,104 | 15,352,216 | 5,689,608 | 2,566,242 | 2,872,768 | 18,369,796 |
| 晶圓級封裝 | | 176 | 881,556 | 551 | 2,564,593 | 236 | 1,018,282 | 620 | 2,563,868 |
| 晶圓測試 | | 981 | 1,722,420 | 836 | 3,128,665 | 1,077 | 1,794,971 | 819 | 3,102,505 |
| 其他 | | — | 7,248 | — | 413,470 | — | 1,287 | — | 157,597 |
| 合 計 | | 10,523,130 | 13,401,920 | 7,365,324 | 53,123,224 | 13,790,619 | 15,347,846 | 8,466,322 | 60,832,803 |

三、從業員工資訊

最近二年度從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率一覽表

| 年 度 | | 108 年度 | 109 年度 | 110 年度截至 3 月 31 日止 |
|---------------------------------|---------|--------|--------|-----------------------|
| 員 工 人 數 | 行政管理人員 | 1,435 | 1,434 | 1,426 |
| | 研發工程人員 | 2,394 | 2,493 | 2,434 |
| | 作業員 | 7,562 | 7,674 | 7,582 |
| | 合 計 | 11,391 | 11,601 | 11,442 |
| 平均年 歲 | | 34.50 | 35.07 | 35.34 |
| 平均服務年資 | | 5.46 | 5.99 | 6.22 |
| 學 歷 分 布 比 率 % | 博 士 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| | 碩 士 | 7.77 | 8.03 | 7.90 |
| | 大 專 | 71.72 | 71.60 | 71.68 |
| | 高 中 | 19.96 | 19.89 | 19.96 |
| | 高 中 以 下 | 0.47 | 0.40 | 0.39 |

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因違反環境法規所受損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及相關處分內容：

1. 新竹縣政府環境保護局於 109 年 5 月 15 日來函（環業字第 1093401212 號），依據 109 年 5 月 13 日稽查工作紀錄，本公司 3C 廠違規事項如下：

(1)標示 D-0899 廢纖維或其他綿、布等混合物之廢棄物貯存區夾雜其他塑膠類廢棄物，R-1908 其他資訊產品廢棄物貯存區存放廢塑膠，未依廢棄物成分特性確實分類貯存，違反廢清法第 36 條第 1 項暨事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第 6 條第 1 項第 1 款規定，罰款 6,000 元整。

(2)標示 R-0201 廢塑膠混合物、廢塑膠貯放未經清洗之廢液空桶，經查該容器原盛裝之液體屬易燃性液體，故該容器空桶應屬易燃性事業廢棄物，應確實標示與分類貯存，違反廢清法第 36 條第 1 項暨事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第 7 條第 1 項第 2 款及第 11 條第四款規定，罰款 18 萬元整。

矯正措施：

(1)已於 109 年 5 月 29 日前完成 3C 廠廢棄物貯存區重新規劃，檢視貯存設施及廢棄物標示，並進行全廠區宣導，加強員工廢棄分類與貯存之工作落實。

(2)重新審視有害廢棄物並設置專用貯存區，並公告廢空桶貯存區域放置。

預防措施：重新檢視廠區環保巡檢/巡視計劃，加強專責人員查核頻率。

2. 新竹縣政府環境保護局於 109 年 6 月 9 日來函（環業字第 1098655225 號），依據 109 年 5 月 13 日稽查工作紀錄，本公司大同廠（3A 廠）積體電路(IC)測試封裝製造程序(M01)之吸附設備(A001)其更換週期不符規範(前次換碳日期為 108 年 10 月 18 日，截至查核日止未有換碳紀錄)(許可證登載規範為 1 次/6 個月)，與固定污染源操作許可證登載規範不符進行操作，違反空氣汙染防制法第 24 條第 2 項規定，罰款 10 萬元整。

矯正措施：立即完成吸附設備(A001)之活性炭更換作業。

預防措施：將活性炭更換時間及頻率訂定於空污防制設備設施年度預防保養計劃中，定期審視並確實執行更換作業。

(二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

1.目前及未來可能發生之估計金額

擬購置之防治污染設備或支出內容如下：

| 項 目 | 單位：新台幣 仟元 | | |
|--------------|-----------|---------|---------|
| | 110 年度 | 111 年度 | 112 年度 |
| 溫室氣體盤查輔導與查證費 | 400 | 400 | 400 |
| 繳交污水處理及排放費 | 30,000 | 31,000 | 31,000 |
| 廢水處理費用 | 37,624 | 40,000 | 40,000 |
| 環保監測檢驗費 | 700 | 800 | 800 |
| 事業廢棄物清除處理費用 | 55,000 | 60,000 | 60,000 |
| 擴充廢水處理設施 | 95,200 | 29,400 | 4,410 |
| 空氣污染測檢驗費 | 1,672 | 1,752 | 1,752 |
| 設置空氣污染處理設施 | 19,700 | 4,700 | 700 |
| 空氣污染防制費用 | 250 | 300 | 300 |
| 支出金額合計 | 240,546 | 168,352 | 139,362 |

2.環境維持措施

(1)環境管理計劃：

為善盡企業社會責任，本公司取得 ISO14000 環境管理系統認證，並透過污染防治設施系統妥善操作，維護永續環境，長期執行下列環境管理措施：

- A.廢氣處理：針對生產過程產生之揮發性有機化合物(VOCs)，本公司亦嚴格控管製程使用之化學品來預防空氣污染，並透過完善的防制設備(如活性碳、洗滌塔等處理設備)，有效抑制空污發生。
- B.製程用水回收：運用廢水回收設備，減少水資源消耗，將製程回收水量來取代自來水使用需求，以達節約用水及保護水資源之目的。
- C.廢水處理：本公司各廠區遵循環保署相關規定，廢水排放皆先經過污水處理系統才排放，且透過即時監控處理設備進行廢水管制，水質皆處理至放流或納管標準才准許排放。
- D.廢棄物清理：生產過程產生之廢棄物，皆依法妥善處理，並在產生廢棄物源頭確實做好分類收集以提高廢棄物之可回收性。
- E.協力廠商稽核與輔導：定期稽核具環境污染風險之供應商與外包商，輔導協力廠商落實環境保護工作，共同履行企業環保責任。
- F.節能減碳與溫室氣體：成立跨部門節能組織，執行節能專案，降低能源消耗與溫室氣體排放量；遵循 ISO14064-1 標準建立溫室氣體盤查管理流程，並委託專業機構進行輔導與查證，揭露碳排放資訊，以符合國際環保趨勢。
- G.自主環境監測：規劃涵蓋廢水水質、噪音音量、空氣品質、廢棄物性質等各類環境自主監測計劃，有效掌控企業活動對環境品質造成之影響與衝擊。
- H.環境許可變更：配合企業活動變化，適時提出各項環境許可之變更；使企業活動與污染排放均能符合環境法令之規範。

(2)環境管理績效

- A.空氣污染防制：

- a.109 年度本公司各廠揮發性有機化合物總排放量為 138.4 噸，每季均依法透過行政院環保署空污費申報系統完成揮發性有機化學品之使用申報及繳費。
 - b.由委外合格廠商提供之定期檢測數據顯示，各廠排放污染物濃度均低於法規限值。
 - c.竹科廠及竹科二廠皆採用最佳可行控制技術(Best Available Control Technology, BACT) 設置沸石濃縮轉輪/蓄熱式焚化爐來處理揮發性有機物(VOCs)，降低對環境之衝擊。
- B.廢水處理及製程回收：
- a.定期檢測放流水水質結果顯示，各項污染物濃度均低於法規限值。
 - b.109 年度本公司各廠區之廢水排放總量為 1,882,198 噸，較 108 年增加 201,226 噸。因 109 年產能上升，故廢(污)水排放總量較 108 年上升。
 - c.109 年力成台灣之封裝製程回收水回收比例為 36%。
- C.廢棄物清理：
- a.廢棄物處理以資源化及回收再利用為優先，將垃圾轉變成有用的資源；本公司竹科廠針對原物料產出之廢液進行回收再利用，廢液減量 151.07 噸/年。
 - b.109 年度本公司資源回收廢棄物可回收項目總重量為 1,023.06 噸，平均每月資源回收量為 85.25 噸。
 - c.每年安排廢棄物清除/處理/再利用廠商現場、書面稽核或不定期跟車抽查，109 年度針對廢棄物廠商共進行了 37 次的定期稽核。
- D.節能減碳與溫室氣體
- a.在廠務設備選購上，選擇高效率機種、選配溫室效應潛勢低的環保冷媒，以降低溫室氣體排放量。
 - b.109 年度本公司通過並取得 ISO 50001 能源管理系統驗證。
 - c.109 年共節電 11,595,401kWh，約 41,743.4 焦耳 (GJ)，達到目標 1% 的節電量。
 - d.新廠設立時，妥善規劃導入綠建築設計，以降低能源、資源耗損之情況。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練及其實施情形

力成科技重視人員的待遇與福利，依據各類獎金發放規範，提供合乎適用法律的員工福利，於每年度結算後之盈餘，扣除相關稅捐、公積及股息後，以固定比例撥予員工酬勞。

人才是支持公司不斷成長的最重要資產，也是企業永續經營的核心關鍵，我們秉持「共創、共榮、共享」的精神，致力於提供員工優質的工作條件，包含具

有優渥、競爭力的薪酬福利及落實女男同工同酬、機會平等之目標，來吸引及留任各方優秀人才，以回饋同仁與公司共同創造佳績的辛勞與貢獻。期望能創造讓員工快樂工作、享受生活的優質環境，使員工安心工作，發揮工作潛能，一同成長。

1.保險方面：

除法定勞健保外，本公司員工均享有免費的團體綜合保險(包括壽險、意外險、醫療險、癌症險...等，員工不需負擔任何費用)。秉持照顧同仁及眷屬的角度，除了員工本人受惠外，亦加惠員工之配偶與子女，同樣享有免費團險。

2.健康與安全方面：

- (1)廠區內備有保健室、哺乳室及醫師駐廠，透過專業醫療人員及健康管理，進行健康促進與管理員工的健康，公司也設有新進員工體檢補助及優於法規的定期員工免費健康檢查，以追蹤員工健康狀況。
- (2)針對健康異常之高風險族群進行風險管控及復工評估，且不定期公佈健康資訊、進行職災防範宣導與安排健康講座。
- (3)對於員工因異常工作負荷促發疾病之預防進行管理，預防發生對象為自覺有異常工作負荷主動通報之同仁，實施健康風險評估、過勞風險評估及佛明罕心血管疾病等評估，駐廠醫師依據綜合評估結果，進行諮詢及紀錄以維護同仁健康。
- (4)力成科技於 2004 年通過 OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統認證，為達預防職傷事故並維護安全和健康之工作場所目標，我們訂定「環境安全衛生政策」，以維護員工的安全和健康。



3.員工協助方面：

員工的健康是企業最大的財富！健康快樂的員工能為公司創造更高效益的績效。力成科技持續推動與提供多元的健康促進方案與關懷機制，並取得「健康職場認證 健康促進標章」，實踐對每位員工身心健康的重視，營造優質的健康工作環境。力成科技致力於提供優於法令的健康檢查、健檢異常追蹤與管理，以及擁心理諮商與員工協助方案等措施，讓力成員工在工作與生活間達到身心健康。

4.旅遊方面：

配合防疫政策並為了維護員工健康，福委會於 109 年將原旅遊活動調整為發放百貨禮券(每人 2000 元)，讓同仁在辛勤工作之餘，可以彈性選擇適合場域與時間與家人朋友一起享受生活。

5.家庭日/大型活動/休閒活動方面：

福委會定期規劃家庭日及其他大型休閒活動，無論是力成員工或員工的家屬，都是力成的一家人，舉辦家庭日活動讓員工與家人一起同樂，讓員工與同事聯繫情感，讓員工與公益並行向前，為員工的工作之餘添上感動與幸福。我們致力於「打造友善職場」，創造讓員工快樂工作、享受生活的優質環境，所以打造專屬力成夥伴的一系列樂活動力，讓員工在工作與生活間達到平衡，讓員工在眾多活動中找到一個自己喜歡的活動，為員工打造力成精彩生活，在工作與生活中獲得持續性動力；同時，也為員工照顧其家庭，讓員工可以於工作時安心全力奮鬥。

6.社團方面：

本公司持續支持同仁自主辦理及參與各式社團活動，目前共有 9 個同仁自主創立的社團，社團性質包含運動類（壘球社、羽球社、保齡球社、籃球社、慢跑社、單車社）、藝文類（手工藝品社、禪學社）、志工類（志工社）等，共計 424 位社員。每年由各社團舉辦活動，讓同仁在工作之餘擁有紓壓管道、強化同事間的情誼、促使家庭和樂美滿。我們照顧力成人，也照顧力成人的家人，藉此達到強健身心、運動習慣之效益。另也透過社團活動的參與，增加同仁與親子互動。

7.休假方面：

本公司比照勞基法規定給予每月例假及年度休假，並定期提供統計報表供主管瞭解關懷同仁休假狀況，以協助同仁達成工作與生活之均衡。

8.生日婚喪及其他福利項目：

- (1)每月發予壽星 500 元祝賀禮券，並針對同仁婚喪喜慶及住院、重大災害等，提供 1,000 至 10,000 元不等的補助金。
- (2)每年勞動節提供 1,000 元等值的現金/禮券/禮品。
- (3)每年端午節及中秋節等節慶，提供各 1,000 元等值的禮券/禮品。
- (4)每年針對年資滿 3、5、10、20 年同仁，給予禮品或禮券一份。

9.生育補助及相關服務：

針對員工本人或配偶生育，提供每胎 2,000 元的補助金，並提供勞保生育給付的相關申請服務。同時我們也關心員工與其家庭的互動，透過福委會簽訂特約員工居住區域的優良幼兒園、托兒機構，提供員工子女就讀的選擇及學前教育的照料，讓同仁無後顧之憂，兼具職場與家庭的幸福生活。

10.食宿方面：

- (1)本公司設有餐廳，提供自助餐，用餐皆有公司補助，同仁僅須支付少許餐費即能享有豐盛之餐點。107 年成立「伙食管理委員會」，透過定期的會議召開討論公司膳食議題，更健全了餐廳及伙食的管控。

(2)為使遠道員工就近解決住的問題，公司備有員工宿舍，提供舒適之生活環境。

11.人才發展：

我們以「傾聽」、「訪談」及「線上調查」等方式來考量公司內部需求與外部新議題，致力滿足「同仁學習的需求」、「產品品質的需求」、「組織成長的需求」及「公司策略的需求」，架構「解決需求導向」的課程辦理模式與訓練體系，更積極培養各階層接班人才，確保企業的永續經營。並針對不同學習對象提供適切的培訓，來促使組織持續發展及創造企業競爭優勢。我們依據教育訓練辦法，於每年度進行年度教育訓練調查，整合單位培訓需求。為使人才培訓與公司營運結合，我們依據法令、法規、認證、客戶需求及人才發展需求，規劃四大培訓藍圖：「力成稽核系統」、「人才職能發展」、「法令政策培訓」及「技能學習移轉」；也因應 COVID-19 疫情延燒，為配合防疫政策，我們透過「線上與書籍自主學習、線上課程與內部講師制度」，推展各類教育訓練，提供員工完整的專業技能養成及自我成長啟發。

(二)退休制度與其實施情形

1.退休申請制度：

力成科技遵照「勞動基準法」及「勞工退休金條例」訂定員工退休辦法，退休申請適用規定如下：

| 退休類別 | 退休要件 |
|---------|---|
| A. 自請退休 | A、服務本公司十五年以上，年滿五十五歲者。 B、服務本公司二十五年以上者。 C、服務本公司十年以上，年滿六十歲者。 |
| B. 強制退休 | A、年滿六十五歲者。 B、身心障礙不堪勝任工作者，所謂身心障礙係指經公立醫療機構認定心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者為標準。 |

2.退休金提撥與實施

設立勞工退休準備金監督委員會，依選擇舊制和選擇新制但保有舊制年資人員按每月薪資總額提撥 2% 提列退休準備金至法定帳戶，並於每年初透過專業的精算顧問進行退休準備金精算評估確保足額。截至 109 年底舊制退休準備金帳戶金額約為 2.8 億元，可滿足勞工符合退休條件時請領退休金；選擇退休新制人員，依法每月提撥薪資 6% 存入勞保局勞工個人帳戶。109 年度會計帳列合計提撥之新、舊制退休金費用及員工提撥合計總額為 367,033 仟元，以期同仁皆能於退休後享有安心的保障。

(三)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.勞資溝通：

力成科技重視同仁的意見與聲音，設有多元暢通的溝通管道以促進勞資雙方之溝通協調，並適時的回應同仁意見，進而檢視相關規範是否須調整改善以期望

更貼近同仁福祉以便落實。此外，透過每季召開的勞資會議及全區福委會，員工代表能針對特定議題反映同仁的建議及看法，任何有關勞資權益的議題藉由議程中的討論，均經勞資雙方充份溝通協議並與公司達成共識，以促進團結，確保溝通管道暢通。

2.全方位溝通管道：

我們建構全方位的溝通管道（如圖所示），隨時關心及傾聽同仁的各種聲音，不論具名或匿名反映，以多元、雙向、開放的反映機制，藉此傳達同仁的心聲，得以有效被處理及回覆，另也建置「再反映管道」讓反映的事件可更客觀及更完善的處理，透過公正、保密、迅速的處理過程，解決同仁的疑惑，並且保護反應事件者，不損及其權益，以建構良好的勞資關係。



(四)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

| 處分日期 | 處分字號 | 違反法規條文 | 違反法規內容 | 處分內容 |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|
| 受檢日： 109/3/20 收文日期： 109/5/21 | 府勞資字第 1093932128 號 | 勞基法 第 32 條之 2 | 延長工作時間超過法令規定 | 罰鍰 5 萬元 |

六、重要契約

| 契約性質 | 當事人 | 契約起訖日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 封測加工承攬合約 | A 公司 | 108.06~ | 封測服務 權利義務規範 | 保密條款 |
| 封測加工承攬合約 | F 公司 | 108.12~109.12 | 封測服務 權利義務規範 | 保密條款 |
| 封測加工承攬合約 | I 公司 | 108.12~111.12 | 封測服務 權利義務規範 | 保密條款 |
| 資產買賣合約 | UTAC | 109.09 | 封測資產交易權利 義務規範 | 保密條款 |
| 銀行 借 款 合 約 | 中國信託商業銀行 | 109.12~112.12 | 中期信用貸款 | 承諾維持一定比例之 資產與負債及淨值 |
| | 兆豐國際商業銀行 | 109.09~112.09 | 中期信用貸款 | 無 |
| | 元大銀行 | 107.11~111.11 | 中期信用貸款 | 承諾維持一定比例之 資產與負債及淨值 |
| | 凱基銀行 | 109.12~113.12 | 中期信用貸款 | 承諾維持一定比例之 資產與負債及淨值 |
| | 玉山銀行 | 106.09~121.09 | 建造廠辦大樓 | 無 |
| | | 106.09~113.09 | | |
| | | 109.05~112.05 | 中期信用貸款 | |
| | 華南銀行 | 109.09~112.09 | 中期信用貸款 | 無 |
| | | 109.03~112.03 | | |
| | | 109.07~112.07 | | |
| | | 109.06~112.06 | | |
| | 第一銀行 | 109.10~114.10 | 中期信用貸款 | 無 |
| | | 107.05~122.05 | 建造廠辦大樓 | |
| | | 107.10~112.10 | | |
| | 台灣銀行 | 101.11~116.11 | 建造廠辦大樓 | 無 |
| | | 106.09~111.09 | 機器設備貸款 | |
| | | 109.06~114.06 | | |
| | 合作金庫 | 106.04~121.04 | 建造廠辦大樓 | 無 |
| | | 106.04~113.04 | 中期信用貸款 | |
| | | 106.09~111.09 | 機器設備貸款 | |
| | 新光銀行 | 109.11~112.09 | 中期信用貸款 | 無 |
| | 彰化銀行 | 106.03~112.03 | 機器設備貸款 | 無 |
| | | 106.06~112.06 | | |
| 108.05~114.05 | | | | |
| 台新銀行 | 109.09~112.09 | 中期信用貸款 | 承諾維持一定比例之 資產與負債及淨值 | |
| 王道銀行 | 109.07~112.07 | 中期信用貸款 | 承諾維持一定比例之 資產與負債及淨值 | |
| 土地銀行 | 109.08~112.08 | 中期信用貸款 | 無 | |
| 匯豐銀行 | 108.09~111.09 | 中期信用貸款 | 無 | |
| | 109.09~112.09 | | | |
| 國泰世華銀行 | 108.11~111.11 | 中期信用貸款 | 無 | |
| 上海銀行 | 109.09~112.09 | 中期信用貸款 | 無 | |
| 日商三菱日聯銀行 | 108.10~111.10 | 中期信用貸款 | 無 | |
| | 109.12~112.12 | | | |